

ニュースガイドNo, 10493A

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成20年(1年間) 60点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥18,900-	¥18,000-
全文紙収録 B5製本版	¥18,900-	¥18,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥28,350-	¥27,000-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10201(B)	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.19	66点	¥23,100
No,10201(A)	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997(C)	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997(B)	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,9997(A)	"	"	平.15	62点	¥18,300
No,9520	"	"	平.13-14	84点	¥16,800
No,9060	"	"	平.11-12	65点	¥24,200
No,8593	"	"	平.9-10	62点	¥23,700
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No,8868	"	半導体ウェーハのメッキ方法と工程	平.5-11	103点	¥35,000
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-12	68点	¥24,700
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点	¥23,200

*お申し込み方法...下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイドNo.
所属部署名	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入
	題名
	合計 ¥
担当者名	E-mail:
	TEL: FAX:
住所: 〒	

料金には別途送料がかかります。

無電解貴金属メッキ方法と工程

No.10493A

[公開編] 平成20年(1年間) 60点

CD-ROM版 ¥18,900 B5製本版 ¥18,900 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥28,350)

1	めっき膜の製造方法、及びめっき処理装置	セイコーエプソン株式会社	30	電子部品搭載用基板	京セラ株式会社
2	金属膜の製造方法、下地組成物、金属膜およびその利用	オムロン株式会社	31	無電解金めっき液およびそれをういためっき方法	関東化学株式会社
3	無電解金メッキ液	独立行政法人産業技術総合研究所	32	パターン形成方法	セイコーエプソン株式会社
4	銀メッキ製品の製造方法	多木化学株式会社	33	無電解金めっき液	ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー,
5	透明導電膜の製造方法	三洋化成工業株式会社	34	固体高分子電解質膜、その製造方法、および電気分解素子	三菱電機株式会社
6	銀めっき付き繊維材料	名古屋メッキ工業株式会社	35	窒化物系半導体発光素子及びその製造方法	昭和電工株式会社
7	部分めっき方法	株式会社オートネットワーク技術研究所	36	無電解金めっき液	エヌ・イーケムキャット株式会社
8	光透過性電磁波シールド材の製造方法、光透過性電磁波シールド材、およびディスプレイ用フィルタ	株式会社ブリヂストン	37	めっき方法	セイコーエプソン株式会社
9	金属配線形成方法	独立行政法人理化学研究所	38	銅表面の処理方法およびこの方法を用いた配線基板	日立化成工業株式会社
10	無電解めっき方法	松下電器産業株式会社	39	ポリイミド樹脂の無電解めっき処理方法	ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー,
11	金属セラミック複合部材に対するメッキ方法、パターン製造方法、および湿式処理装置、並びにパワーモジ...	DOWAホールディングス株式会社	40	半導体チップ積層実装体の製造方法	吉玉精鍍株式会社
12	銀器類の改良方法	八藤 真	41	無電解金めっき方法及び電子部品	上村工業株式会社
13	光透過性電磁波シールド材の製造方法	株式会社ブリヂストン	42	電子部品の無電解金めっき方法及び電子部品	日立化成工業株式会社
14	回路形成用基材およびその製造方法	東海ゴム工業株式会社	43	耐食導電被覆材料及びその用途	日本カーリット株式会社
15	銀メッキ製品用変色抑制剤	多木化学株式会社	44	無電解めっき装置	セイコーエプソン株式会社
16	導電性中空体およびその製造方法	松本油脂製薬株式会社	45	接続端子、接続端子を用いた半導体パッケージ及び半導体パッケージの製造方法	日立化成工業株式会社
17	ポリイミド配線板の製造方法	シャープ株式会社	46	無電解めっき前処理剤、それをういる無電解めっき方法、及び無電解めっき物	日鉱金属株式会社
18	半導体チップ搭載用基板及び前処理液	日立化成工業株式会社	47	無電解金めっき液	日鉱金属株式会社
19	銀めっきボタン	角元 克己	48	導電性微粒子、導電性微粒子の製造方法、及び、異方性導電材料	積水化学工業株式会社
20	めっき方法	セイコーエプソン株式会社	49	導電性微粒子、導電性微粒子の製造方法、及び、無電解銀メッキ液	積水化学工業株式会社
21	無電解金めっき浴、無電解金めっき方法及び電子部品	上村工業株式会社	50	無電解めっき方法、およびめっき皮膜が形成された非導電性被めっき物	株式会社村田製作所
22	無電解金めっき浴、無電解金めっき方法及び電子部品	上村工業株式会社	51	無電解金めっき液	日鉱金属株式会社
23	配線構造、配線形成方法及び配線形成装置	株式会社荏原製作所	52	導電性微粒子、及び異方性導電材料	積水化学工業株式会社
24	無電解金めっき浴のめっき能維持管理方法	上村工業株式会社	53	樹脂基材、それに無電解めっきを施した電子部品基材、および電子部品基材の製造方法	日鉱金属株式会社
25	貴金属被膜の形成方法	住友大阪セメント株式会社	54	めっき基材	日鉱金属株式会社
26	パラジウム皮膜用還元析出型無電解金めっき液	奥野製薬工業株式会社	55	電子部品製造における銀めっき	エントン インコーポレイテッド
27	金メッキ液および金メッキ方法	三菱化学株式会社	56	カルコゲニド型メモリ・デバイスのための金属キャップの無電解メッキ	マイクロン テクノロジー, インコーポレイテッド
28	置換錫合金めっき皮膜の形成方法、置換錫合金めっき浴及びめっき性能の維持方法	上村工業株式会社	57	自己触媒無電解法の改善された安定化及び性能	ポリマー コンポジター イー エーテポリ アクチボラゲット
29	無電解パラジウムめっき用活性化組成物	奥野製薬工業株式会社			

以下3点省略